

深圳市龙图光罩股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

深圳市龙图光罩股份有限公司(以下简称“公司”)认为提高上市公司质量,增强投资者回报,提升投资者的获得感,是上市公司发展的应有之义,是上市公司对投资者的应尽之责。为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任,公司特制定 2025 年度“提质增效重回报”行动方案,以进一步提升公司经营效率,强化市场竞争力,保障投资者权益,稳定股价,树立良好的资本市场形象。主要措施如下:

一、聚焦经营主业,提升核心竞争力

公司主营业务为半导体掩模版的研发、生产和销售,是具备关键技术攻关能力,拥有自主知识产权的独立第三方半导体掩模版厂商。公司紧跟国内特色工艺半导体发展路线,不断进行技术攻关和产品迭代,量产的半导体掩模版对应下游半导体产品的工艺节点覆盖 130nm,更高制程节点的第三代掩模版 PSM 产品已研发试制成功并送往客户验证。

公司掩模版产品广泛应用于功率半导体、MEMS 传感器、IC 封装、模拟 IC 等特色工艺半导体领域,终端应用涵盖新能源、光伏发电、汽车电子、工业控制、无线通信、物联网、消费电子等场景。公司于 2022 年 8 月设立珠海市龙图光罩科技有限公司(以下简称“子公司”或“珠海公司”),紧随国家半导体行业发展战略,围绕高端半导体芯片掩模版领域,持续加大研发投入,逐步实现 90nm、65nm 以及更高节点掩模版的量产与国产化配套,深耕特色工艺,突破高端制程,立志成为国际一流的半导体光罩企业。

2025 年,公司将从项目投产、技术升级、降本增效、人才培养、客户服务等多维度发力实现高质量发展,力争在增加公司营业收入规模的同时,继续提升公司的技术实力,扩大覆盖的制程节点和客户范围,并保持较为稳定的盈利能力,给投资者带来稳定、可预期的回报,主要措施如下:

1、紧抓项目投产，拓宽应用领域

公司目前量产产品为 130nm 及以上制程节点半导体掩模版，产品主要应用于功率半导体、MEMS 传感器、IC 封装等半导体领域。2025 年，公司将完成珠海募投项目的建设投产，通过与现有客户及潜在客户的紧密合作，完成第三代光罩产品的客户验证、小批量试产、批量供货，进一步拓宽产品覆盖的制程节点，增加营业收入规模，提升公司的市场竞争力。

2、加快技术升级，优化产品结构

公司对第三代半导体掩模版技术的全流程进行了充分的技术研发和工艺调试，包括版图数据处理、OPC 补偿、电子束光刻、相移掩模技术、干法刻蚀、缺陷检测及修补等。2025 年，公司将根据市场发展趋势、下游客户需求以及行业动态合理规划，在现有产品技术和工艺的基础上，进一步加大技术开发和创新。公司将着重提升研发能力，持续增加技术研发的投入，从产品的材料、工艺、品质以及生产管理等方面持续创新，通过技术升级优化产品结构和产能配置。

2025 年，公司将持续增大研发深度，拓宽研发广度，公司重点投入的研发项目与预计取得的成果如下：

序号	项目名称	预计目标
1	基于电子束光刻技术的掩模版工艺开发项目	提高产品最小分辨率，及 CD 精度
2	基于 ICP 技术的掩模版干法刻蚀工艺开发	实现 CDU 与 etch bias 的大幅度优化，改善遮光层 profile 性能
3	制程精度检测精准度与及时性提升项目	改善测量系统的性能和适用范围，提升制造过程中精度检测的效率与工艺改善及时性
4	应用于半导体掩模版 Contact 层的 AOI 检查优化项目	满足不同形式 Contact 层的兼容检测，提升检测的通用性
5	湿法工艺侧壁角优化技术研发项目	减小湿法刻蚀 bias，改善线边粗糙度，提升产品刻蚀工艺的精度和制程能力
6	特色工艺用掩模版 local CDU 的改善优化项目	实现产品 Edge Roughness<5nm 、 CD Linearity<10nm
7	应用于 CMOS 图像传感器的掩模版项目研发	开发应用于 CMOS 图像传感器的掩模版产品
8	多尺寸规格掩模版 overlay 精度提升项目	提升多种尺寸掩模版间的 overlay 精度，减小因基板尺寸差异影响的位置精度偏差
9	三维掩模版侧壁角检测优化系统开发项目	通过对测量数据处理，利用编程软件实现侧壁角的实时自动化计算及合规性对比
10	PSM 掩模版的工艺制程良率提升	提升 PSM 掩模的工艺制程良品率

序号	项目名称	预计目标
	升研究项目	
11	显影方式优化对图像精度及缺陷改善的研究项目	提升掩模版图像精度，降低缺陷率
12	基于高精度半导体掩模版的检测算法研究	提升高精度半导体掩模版检测效率与检出能力
13	基于 0.13 μm 节点的 Laser 和 dry etch 工艺良率提升研究项目	提升 0.13 节点半导体用掩模版工艺良品率，产品 CD Linearity 小于 15nm，CD Iso-Dense 小于 20nm

2025 年公司将持续聚焦研发创新能力建设，在人才队伍打造上，将进一步优化薪酬体系、完善激励机制，全力锻造一支高素质、专业化的研发团队，注重研发成果与市场需求相结合，不断加快工艺创新、完善关键技术和产品专利布局，为客户创造更大的价值。

3、贯彻精益生产，推动降本增效

2025 年，公司将继续强化管理平台建设。在生产管理上，公司将加快新 MES 系统上线运行，实现工艺选择自动化、管理流程化，推进精细化管理。在成本管理中，突出流程管控，强化费用管控，重点通过技术创新、工艺优化、国产替代、人员激励等方式来降本增效，力求维持较为稳定的盈利能力。

4、加强人才培养，提升团队建设

2025 年，公司将不断优化人才结构，加大人才引进力度，吸引行业优秀人才加盟；同时，持续完善员工激励机制，建立多样化的奖励机制，包括开展荣誉奖励、实施股权激励计划等。公司将借助上线培训系统鼓励员工自主学习，不断提升员工技能，促进员工个人成长和发展。公司致力于营造积极的学习型文化氛围，激发团队主动性和创造性，尊重人才发展、关爱员工成长。

5、聚焦客户服务，提升品牌价值

2025 年，公司将继续聚焦客户服务水准和服务效率，确保客户产品稳定供货，推进新产品顺利验证和导入。同时，公司将准确理解客户需求，建立高效沟通渠道，做好技术对接和工艺匹配，增加客户对公司品牌和产品的认可度。

二、持续加强募投项目管理，提升公司科技创新能力

2024 年 8 月，公司在上海证券交易所科创板挂牌上市，募集资金总额为人

民币 6.17 亿元。上市以来，公司使用募集资金投入“高端半导体芯片掩模版制造基地项目”、“高端半导体芯片掩模版研发中心项目”，力求加快项目建设。目前，IPO 募集资金使用比例已超过 90%。

2025 年，公司将会持续加强募投项目管理，在募投项目的实施过程中，严格遵守募集资金管理规定，审慎使用募集资金，切实保证募投项目按规划顺利推进，以募投项目的落地促进公司主营业务发展，实现募投项目预期收益，增强公司整体盈利能力。具体如下：

1、高端半导体芯片掩模版制造基地项目

截至 2024 年年末，高端半导体芯片掩模版制造基地项目累计投入 51,541.44 万元，累计投入进度为 96.62%；截止本行动方案日，公司珠海工厂已完成第三代掩模版 PSM 产品的工艺调试和样品试制，并已送样至客户进行验证。随着上述项目的推进，公司产品制程水平将拓展至 90nm、65nm，实现制程升级和产品迭代，下游应用领域也将向驱动芯片、MCU、信号链、CIS、Flash、eNVM 等扩展，充分满足下游大型晶圆厂的配套需求，在扩大市场份额的同时，提升公司产品的竞争力，强化公司的领先优势。

2、高端半导体芯片掩模版研发中心项目

高端半导体芯片掩模版研发中心项目累计投入金额为 827.61 万元，累计投入进度为 41.38%。该项目是对公司现有或未来主要产品及核心技术的进一步开发、升级与创新，公司将通过自筹资金、合作研发等方式，继续增加研发投入，继续保持公司的研发优势，加快更高制程节点产品的转化。

三、重视股东回报，共享发展成果

公司高度重视投资者回报，积极进行现金分红，切实让投资者分享公司的发展成果，提升获得感。公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.00 元（含税）。截至 2025 年 2 月 28 日，公司总股本 133,500,000 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 5,340.00 万元(含税)，占公司 2024 年度归属于母公司所有者的净利润的 58.15%。

2025 年，公司将根据所处行业状况，结合公司实际业务情况、未来发展规

划、资金情况，妥善协调好资本开支、经营性资金需求与现金分红的关系，根据法律法规及《公司章程》《上市后三年内股东分红回报规划》的规定并结合公司实际运营情况进行分红，切实提升股东回报水平，将“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制落在实处。

四、坚持规范运作，优化公司治理

公司高度重视治理结构的健全和内控体系的有效性，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和监管要求，不断完善公司治理体系。目前，公司已建立由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的法人治理机构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责分明、运作规范、相互协调、相互制衡的公司运作机制，为公司高效、稳健经营提供了组织保证。此外，公司构建了一套全面的内部管理与控制体系，覆盖预算管理、销售与收款、采购与付款、对外投资以及关联交易等各个关键环节，从而有效控制了经营风险，促进了公司管理的规范化、运营的效率化。

2025 年，公司将紧跟政策指引，严格落实各项制度改革举措，结合自身发展实际与业务特点，对现有的内部管理体系和规章制度展开全面、深入的梳理工作，持续优化公司治理结构，切实提升规范运作水平。同时，公司将在严格遵循内部控制相关要求的基础上，积极探索管理创新路径，充分借鉴行业先进经验，结合公司实际情况，构建一套高效且具有针对性的内部控制管理体系，通过优化流程、强化监督、完善风险防控机制等方式，全方位提升公司管理效能，保障企业资源得以合理配置与高效利用，为公司的可持续发展奠定坚实基础。

2025 年，公司将进一步加大对“关键少数”履职的支撑保障力度，通过提供履职信息支持、协助组织专题培训、现场沟通等多元化方式，全力协助“关键少数”履职。在信息交互方面，公司将确保信息传递的畅通、及时、对称与有效；针对“关键少数”就公司经营情况、监管要求等方面提出的问题，公司将以最快速度予以专业回复；同时，高度重视“关键少数”提出的专业意见和建议，将其切实转化为推动公司管理水平提升的重要动力。

在规范“关键少数”行为方面，公司将严格明确其权利与义务，建立健全监督机制，防止“关键少数”滥用股东权利，切实保护中小投资者的合法权益；同时，持续加强对“关键少数”股份变动相关要求的宣传与贯彻工作，定期对控股股东、持股 5%以上股东以及董监高的持股情况进行细致核查，确保股份变动合规有序。

五、提升信息披露质量，强化投资者关系管理

公司始终高度重视信息披露工作，严格遵守相关法律法规和规范性文件的要求，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。上市以来，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的监管要求开展信息披露业务，维护投资者获取信息的平等性，致力于保障投资者的知情权。为了不断提高信息披露质量，公司将持续提升信息披露义务人的责任意识，积极参与监管部门组织的信息披露专项培训，加强对内幕信息等重点事项的管理，防范信息披露风险。

公司始终高度重视投资者关系管理，不断完善投资者关系管理相关的规章制度，持续优化与投资者的沟通工作，通过公司官网、投资者热线电话、邮箱、上证 e 互动、券商策略会、分析师会议、反路演、路演、网络会议、现场参观、媒体采访、业绩说明会等线上线下相结合的方式加强与投资者的联系与沟通，增强投资者对公司的了解与信任，积极传递公司投资价值。

2025 年，公司将紧密围绕投资者需求，严格依照法律法规及相关监管要求，切实履行信息披露义务，进一步提升信息披露的透明度和可读性，为投资者进行投资决策和价值判断提供更充分的依据。在投资者关系管理方面，公司将持续深化相关工作，不断加大与资本市场的沟通力度，着力构建渠道多元、系统连贯、频度与深度并重的工作机制。通过公司官网、微信公众号等媒介采用图文、视频等可视化方式对定期报告、临时公告进行解读积极探索并完善投资者权益保护的有效途径和方式，通过提升投资者关系管理水平，持续改善公司的市场形象、提升品牌价值，增强投资者对公司的信心和信任，建立长期稳定相互信赖的关系。

六、其他

2025 年，公司积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”行动的倡议》，系统推进首期专项行动方案。公司严格贯彻落实方案中的

各项举措，在经营发展、研发创新、治理结构、投资者交流与回报等多个关键领域均取得了显著成效。该项专项行动有效驱动公司构建高质量发展新范式，提升投资者的获得感，促进了公司与资本市场之间的双向、持续且平稳健康的发展，具有重要战略意义和实践价值。

此外，公司将秉持“以投资者为本”的上市公司发展理念，定期对“提质增效重回报”行动方案的实施情况进行评估，适时调整具体举措并更新行动方案，与公司战略和市场需求保持同步，及时履行信息披露义务。同时，公司将通过持续规范公司治理、提升信息披露质量、加强与投资者沟通、强化投资者回报效能，切实履行上市公司的责任和义务，不断提升公司的投资价值。

本《行动方案》的内容是基于公司当前实际情况进行分析并作出的判断，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性。有关公司规划、发展战略等内容系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

深圳市龙图光罩股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日